PAKCOOL TPC-213 Thermally Conductive Potting Compound



주요 성능 및 장점:

- 열전도율: 1.3 W/m·K
- 넓은 범위의 경도 값 구현 가능, 다양한 포팅 작업 가능
- 낮은 열팽창, 최소한의 부품 충격을 위해 제 작됨
- 100% 솔리드 경화 시 부산물 미발생
- 탁월한 저온 & 고온 저항성
- 기계적 & 화학적 안정성

PAKCOOL TPC-213은 고성능 열전도성 액상 포팅 제품으로, 2액형으로 공급되며 상온 또는 가열에 의해 경화가 이뤄지는 시스템입니다. 이 제품은 균형 잡힌 높은열 전도율과 낮은열 팽창율을 가지고 있으며, 포팅또는 뜨거운 전자부품 및 히트 싱크의 갭 필러로 사용가능합니다. 경화 전, 액상 자체의 탁월한 흐름성으로인해 토출 및 포팅 작업에 용이합니다. 경화 후, 열사이클(열충격)조건에서도 PUMP (도포된 액상의 새어나옴 현상) 현상이 없습니다.

제품 용도:

- 동력 변환기
- 전원 반도체
- 파워 서플라이
- 전장용 전자 부품
- 동작 제어 장치
- 통신 장비
- 컴퓨터 및 주변 장치
- 열방출 반도체 사이, 또는 자석 부품 및 히트 싱크
- 열 전도가 필요한 프레임, 섀시 또는 그 외 열 방출 장치

OIHL 서느	TPC-213	시치 바出
일반 성능	IPC-213	실험 방법
기본 자재	실리콘	-
10.15	A-백색	0.01 ±1.01
색상 	B-회색	육안 확인
혼합 비율	1:1	-
Tie	A: 5500±500	D L.C L.J. 2.#
점도	B: Part A 보다	Brookfield 3#
(cPs@ 25°C±2)	200~300 cps 낮음	spindle, 25RPM
가사시간	20 H	
(분 @ 25℃)	30 분	-
열전도율	12.01	A CTA A D F 470
(W/m·K)	1.3±0.1	ASTM D 5470
경도 (Shore A @	45.5	A CTN A D 2240
150°C/15min)	45±5	ASTM D 2240
비중 (g/cm³)	2.20±0.05	ASTM D 792
절연 강도	20	ASTM D 149
(kV/mm)	20	A31W D 149
유전율 (MHz)	4.7	ASTM D 150
체적저항 (Ω·cm)	≥3.3 x 10 ¹³	ASTM D 257
유효기간 (@<20℃)	12개월	-
가연성	V-0	04
(UL file# 314256)	V-U	UL-94
사용 온도 범위	-50~+200°C	-

대략적인 경화 시간

PAKCOOL TPC-213은 열전도성 콤파운드 제품으로 상 온에서 8~24시간 이후에 경화 됩니다. 하기의 온도 조 건에 따라 완전 경화가 진행되는 시간을 확인 바라며, 대략적인 측정 값임을 인지 바랍니다.

25℃	24 시간
70℃	40 분
100℃	25 분
125℃	20 분

제품 문의: +82-10-3613-8068

For customers who cannot find exact match for their need, Chooyu Chemical can work on a customized upgrade of one of our standard offerings. Some examples of how fast formulation can meet your exact needs include, but are not limited to, the following: modification of a product cure schedule, modulus, viscosity, or color - all in a timely manner. If customers need more detailed information please contact our customer service department, they are always available to assist you.